

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2024-020



深圳市金百泽电子科技股份有限公司

2023 年年度报告摘要

2024 年 04 月

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	金百泽	股票代码	301041
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈鹏飞		
办公地址	深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼		
传真	0755-2673 3968		
电话	0755-2652 5959		
电子信箱	investor@kingbrother.com		

### 2、报告期主要业务或产品简介

金百泽成立于 1997 年，公司专注电子互联技术，聚焦电子产品研发和硬件创新领域，通过集成与设计制造 IDM 为客户的产品研发和硬件创新提供垂直整合的一站式解决方案。同步打造科创服务、数字化平台服务等多项业务，致力于打造世界级电子产品研发和硬件创新服务平台。

报告期内，公司的主要业务未发生重大变化，公司的主要业务可分为集成与设计制造 IDM 下的电子设计服务、印制电路板 PCB、电子制造服务 EMS 以及科创服务、数字化平台服务等。

公司服务的代表行业 and 产品的代表应用如下图所示：

<p><b>工业控制</b></p>  <p>工业机器人 工业控制板 工业监控系统 工业检测仪等</p> 	<p><b>电力系统</b></p>  <p>特高压 高压电子 变频变压 智能电表等</p> 
<p><b>新能源</b></p>  <p>充电桩 风力发电 光伏发电 清洁能源等</p> 	<p><b>信息技术</b></p>  <p>天线基站 无线传输 数据通信 光电转换等</p> 
<p><b>智能硬件</b></p>  <p>消费电子 智能穿戴 智能家居 视听设备等</p> 	<p><b>人工智能</b></p>  <p>机器人 图像识别 计算机视觉 科学计算等</p> 
<p><b>无人机领域</b></p>  <p>高光谱成像仪 飞控导航 激光雷达 载荷系统等</p> 	<p><b>汽车电子</b></p>  <p>车载雷达 智能驾驶 座舱智能化 车载定位系统等</p> 
<p><b>医疗设备</b></p>  <p>呼吸机 红外测温仪 基因测序仪 影像采集系统等</p> 	<p><b>智慧城市</b></p>  <p>物联网 智能监控 智能家居等</p> 

**1、集成设计与制造 IDM**

**(1) IDH 方案设计**

公司坚持以“设计先行，协同创新”的经营策略，为客户提供电子产品模块、底板、核心板、整版个性化定制搭配等垂直整合解决方案，致力于成为特色的电子产品研发和硬件创新集成服务商。基于让创新更简单的服务理念，公司重点推出电力、物联网、汽车电子、医疗电子、新能源等细分行业的基于 IDM 的硬件智能控制模组方案，赋能战略大客户的“集成创新”；

公司设立省级特种电子电路工程中心、电子工程实验室，提升 KB EDA/DFX 及可制造性设计能力，利用 DFX 系统构建元器件 3D 建模，完成 DFA 可装配性仿真，提前模拟 PCBA 试装配，提前发现和设计 DFX 的相关障碍，做到质量预防(优化设计和工艺补偿)，保障产品的可靠性质量的落地。

**(2) PCB 设计**

电路板设计 Layout：主要为客户提供高速、高密、高可靠性的 PCB 设计。资深团队，独有的专业工具，从功能设计到工程设计，为产品构魂。基于公司长期服务 10000 多家客户的产品研发和 PCB 设计经验积累，形成了丰富的可制造性设计 DFM 数据库，通过开展电子设计服务，满足客户加快研发创新速度和减少设计变更频率的需求。

公司在北京、深圳、惠州、西安、成都、武汉、长沙等重点城市设立了多个 PCB 设计部，由经验丰富的工程师组成设计团队，服务于全球创新型客户。

自主开发的 EDA 辅助工具 KBEDA-Skill1，适用于主流 PCB LAYOUT 软件，让 PCB 设计更简单。拥有 400 多个不同应用功能，其中多项功能获得软件著作权和专利授权。该软件工具为工程师提升设计品质和设计效率，帮助客户缩短周期。另外，自主开发的 KBEDA-DFM，基于对设计源文件的评审，更加直接、高效，包括可制造性的审核、设计规范性的审核，可在线检测并分享和修改异常。

金百泽电子封装库，是基于二十余年技术沉淀，资源库已达到 10 万+种不同类型的元器件。KBEDA-LIB 打造了电子设计资源封装库管理系统，实现标准规范 EDA 库的统一管理和维护、并建立库流程管理机制，实现了自动化、智能化、标准化的 EDA 库平台。

### **(3) PCB 样板和中小批量研发生产**

印制电路板 PCB 是电子产品的核心电子互连件，起到为各类电子元器件提供机械支撑、电气连接和信号传输的作用。印制电路板几乎存在于所有的电子设备中，电子产品的可靠性和稳定性很大程度上依赖于印制电路板的制造品质，因此印制电路板被称作“电子产品之母”。公司的 PCB 业务聚焦电子产品研发阶段的 PCB 样板和中小批量板需求。

公司拥有惠州大亚湾和西安两大印制电路板生产基地，通过了 ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO45001、GJB9001CCQC、AEO、UL、REACH 等质量管理体系及环境管理体系认证；拥有高精密先进自动化设备，具有实现数据化、可视化、高可靠性产品的交付能力。产品类型覆盖高多层电路板、HDI 板、刚挠结合板、高频板、金属基板、厚铜电路、嵌入式印制电路板等；产品应用领域覆盖智慧城市、信息技术、工业控制、汽车电子、医疗设备、电力系统、新能源、军工、消费电子、人工智能、无人机及科研院所等众多领域；具有多品种、小批量、短交期、相对高毛利的特点。

公司以 PCB 样板为入口，顺应各行业电子化升级和个性化需求趋势，发展中小批量 PCB 板，满足越来越多的客户对 PCB 样板和 PCB 中小批量一站式采购的需求，有效突破样板市场的规模限制。

### **(4) EMS 特色创新电子制造服务**

电子制造服务致力于为客户提供垂直整合的一站式解决方案。据统计报导，EMS 市场规模是 PCB 市场的 7-10 倍，具有广阔的发展空间和应用范围。PCB 作为电子产品之母，EMS 电子制造服务与其具有客户同源、技术同根、产品沿袭的特点。PCB 与 EMS 一站式服务简化了客户的供应链管理和技术服务的外包流程，增加了客户的粘性和技术的围堰，多品种、小批量、PCB 与 EMS 全流程服务已成为客户对供应链的策略性需求，具有广阔的市场前景。

公司的 EMS 特色电子制造服务专注于电子产品研发和工程服务需求，为客户提供包括 PCBA 电子装联服务、BOM 齐套方案服务、元器件检测与可靠性服务，通过可制造性设计 DFM 和可装配性设计 DFA 约束规则、可采购性设计 DFP 工程数据，提供产品的可制造性和产品的可靠性保障，为客户提供精准的定制化服务。

## **2、科创服务**

27 年来，公司始终专注于电子电路集成电子产品设计与硬件创新服务，为客户提供包含硬件设计、软件设计、工业设计、BOM 技术等高质、高可靠性的硬件产品创新、设计和制造服务一站式硬件产品创新解决方案。

科创服务，是公司多年的技术积累和产业实践积累回馈、助力电子信息产业发展的综合业务。公司根据时代需求，不断加强科创业务拓展。基于 27 年的科创实践，公司以技术服务、智造服务、产业服务为核心，进而延伸至人才培养与人力资源服务、工业资本服务和科技成果转化服务，从技术、供应链、产业，到核心技术人才、工业资本和成果转化，最大限度降低科技企业、创新创业团队、高校、科研机构和创业者的技术难题、供应链难题、产品中试与制造难题、核心技术人才难题、融资难题等创新创业障碍，大大降低创新创业的资金投入和产品研发风险，加速产品落地速度，有效提升产品质量，为创新产品的落地保驾护航，真正实现为创新型科技产品从设计、研发、中试、检测到量产的一站式技术型科创加速服务，助力了电子电路产业创新企业的壮大与发展，进而促进了公司业务的持续发展。

## **3、数字化平台服务**

通过持续的技术投入和产业实践，积累了丰富的工业互联网和工业数字化转型经验，构筑了自主可控的数字化业务中台和敏捷的集成供应链交付体系，从而打通了从研发、设计、制造到采购等产业链上下游资源，构建了新型的数字化供应链云平台。

公司基于行业理解与数字化实践经验，联合数字化生态合作伙伴，提供全套行业中制造企业数字化转型解决方案

赋能，助力行业工业软件国产化发展，打造了造物数科数字化中试平台建设服务能力。通过造物应龙智慧云工厂平台，链接集成客户硬件产品创新云服务，通过自主可控的数字化业务中台和集成供应链交付能力，构建柔性精益的营销协同、设计协同、生产协同与供应协同体系，加速客户硬件产品的创新。聚合从研发、设计、制造、采购到物流等领域的合作商，建立新型的数字化供应链平台，通过数字化技术实现产业链上下游、产业集群的业务一体化融合，为产业创造价值，为客户提供优质的产品与服务。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	906,741,791.86	835,555,825.93	8.52%	869,367,888.90
归属于上市公司股东的净资产	668,099,558.77	633,582,490.64	5.45%	607,495,728.67
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	635,698,072.24	651,657,182.91	-2.45%	699,431,896.24
归属于上市公司股东的净利润	39,637,708.13	33,874,401.97	17.01%	51,403,257.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,146,861.38	24,312,181.35	28.11%	38,769,388.25
经营活动产生的现金流量净额	104,607,486.87	27,461,204.11	280.93%	49,047,187.73
基本每股收益（元/股）	0.37	0.32	15.63%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.32	15.63%	0.58
加权平均净资产收益率	6.09%	5.46%	0.63%	10.70%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	148,729,396.69	160,351,657.25	156,817,130.93	169,799,887.37
归属于上市公司股东的净利润	3,981,293.51	14,794,036.64	8,227,596.16	12,634,781.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,099,463.69	12,970,856.90	6,244,597.13	8,831,943.66
经营活动产生的现金流量净额	12,817,562.78	36,957,720.34	7,990,705.99	46,841,497.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,027	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,492	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
武守坤	境内自然人	34.47%	36,776,232	36,776,232	不适用	0			
张伟	境内自然人	8.66%	9,242,000	0	不适用	0			
武守永	境内自然人	7.64%	8,148,000	8,148,000	不适用	0			
深圳光影资本管理有限公司—光影丰赞 5 号私募证券投资基金	其他	0.69%	735,800	0	不适用	0			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.58%	613,957	0	不适用	0			
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.55%	581,4690	0	不适用	0			
陈家夫	境内自然人	0.54%	572,604	0	不适用	0			
UBS AG	境外法人	0.49%	525,838	0	不适用	0			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.47%	503,502	0	不适用	0			
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.44%	470,739	0	不适用	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	武守坤与武守永为同胞兄弟关系。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

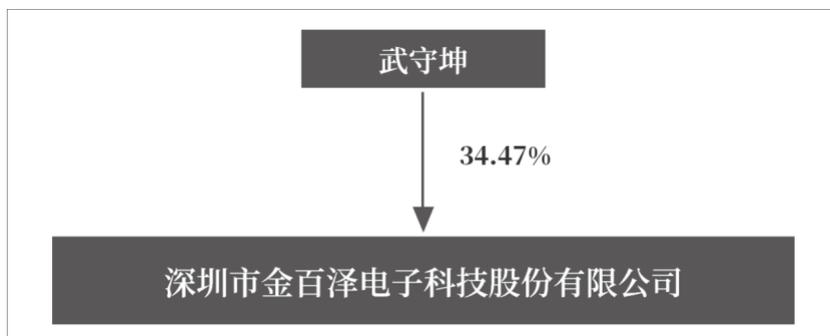
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	退出	0	0.00%	150,019	0.14%
深圳市花梦资本管理有限公司—花梦33号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利5号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
深圳市同晟金泉投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
深圳市凯硕投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
周岳豪	退出	0	0.00%	95,000	0.09%
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	退出	0	0.00%	0	0.00%
深圳光影资本管理有限公司—光影丰赞5号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	735,800	0.69%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	613,957	0.58%
BARCLAYS BANK PLC	新增	0	0.00%	581,469	0.55%
陈家夫	新增	0	0.00%	572,604	0.54%
UBS AG	新增	0	0.00%	525,838	0.49%
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	503,502	0.47%
广发证券股份有限公司	新增	0	0.00%	470,739	0.44%

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

**(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

公司报告期无优先股股东持股情况。

**(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系****5、在年度报告批准报出日存续的债券情况**

适用 不适用

**三、重要事项**

1、爱建证券有限责任公司作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，原委派何侯先生、曾辉先生担任持续督导保荐代表人，因何侯先生工作调整原因不再负责金百泽的持续督导保荐工作，授权丁冬梅女士接替何侯先生担任金百泽持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2023-001）。

2、2022 年 8 月 19 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（以下简称“预披露公告”），公司持股 5%以上股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司（以下简称“达晨财信”）拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式，减持公司股份不超过 3,200,400 股，即不超过公司总股本的 3%（其中大宗交易不超过 3,200,400 股，集中竞价不超过 2,133,600 股）；预披露公告之日起至 2023 年 3 月 9 日，达晨财信通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持公司股份合计 3,039,292 股，占公司总股本的 2.8490%，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于特定股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2023-005）。

3、2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于部分募投项目新增实施主体及募集资金专户的议案》，新增公司及其全资子公司造物云为“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”的实施主体，同时增加造物云募集资金专户。2023 年 5 月 19 日，公司及全资子公司造物云与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构爱建证券有限责任公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目新增实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2023-017）及《关于新增募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-025）。

4、2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总股本 106,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.48 元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币 5,120,640.00 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

5、公司与天府科创投拟结合各自优势资源共建“星创惠泽基金”，并探索聚焦“基金投资+服务赋能”协同发展的模式。公司将与天府科创投共同围绕星创惠泽基金的运营与管理，细化和完善合作模式，并签署了《共同设立“四川天

府新区星创惠泽基金”战略意向合作协议》。2023 年 10 月 10 日，公司与四川天府新区天沃投资有限责任公司、四川天府新区天升坤祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）、四川天府新区星盈企业管理合伙企业（有限合伙）共同签署了《四川天府新区星创惠泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司认缴出资 2,000 万元，出资比例 19.46%。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日、2023 年 10 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与专业投资机构签署战略意向合作协议的公告》（公告编号：2023-029）、《关于签署四川天府新区星创惠泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议的公告》（公告编号：2023-040）。

6、公司与全资子公司深圳市金百泽科技有限公司（以下简称“金百泽科技”）拟与其他机构共同投资海南百彦二期半导体产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南百彦”或“合伙企业”）。其中，公司作为海南百彦的有限合伙人之一，使用自有资金认缴出资 990 万元；金百泽科技为海南百彦的普通合伙人之一，使用自有资金认缴出资 10 万元，本次投资完成后公司和金百泽科技将合计持有海南百彦 25%的合伙份额。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-048）。

7、公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并由公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 13 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-046）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-049）。

8、公司董事会同意公司参加知识产权资产证券化项目，将公司及子公司名下有权处分的四项专利权质押给深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”），向高新投小额贷款申请最高额度不超过人民币 4,000 万元、期限为一年期的综合授信；并委托深圳市高新投融资担保有限公司为公司上述授信提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参加知识产权资产证券化项目及融资的公告》（公告编号：2023-045）。